

Nuova linea di accessori per MICROCOOL

Roma, 16 agosto 2006 - MICROCOOL, azienda di riferimento dell'I.T. per la gestione termica di componenti delle schede madri e processori, è lieta di presentare la nuova linea di accessori dedicata agli appassionati di modding più esigenti, introducendo gli adesivi termoconduttivi Chomerics della serie Thermattach® ed i gommini protettivi salva core.

THERMATTACH® T411 è un adesivo sensibile alla pressione, con elevata forza adesiva e composto internamente da uno strato di alluminio espanso reticolato. Quest'ultimo consente all'adesivo di adattarsi alle superfici non planari dei package plastici dei componenti IC, fornendo un'elevata forza adesiva per il fissaggio dei dissipatori. L'ulteriore strato siliconico (PSA) ad alte prestazioni consente, in fine, l'adesione alle plastiche contaminate da silicone e ad altre superfici a bassa energia. Il T411 trova il suo impiego ottimale nel fissaggio di dissipatori di grosse dimensioni dove la forza adesiva è fondamentale. In particolare è indicato per il montaggio di pesanti dissipatori in rame sulle memorie BGA delle schede video o più in generale per far aderire perfettamente sia dissipatori in alluminio che in rame su chip incapsulati in packaging plastici, come chipset o processori, che, a causa della loro superficie leggermente concava e della presenza di prodotti siliconici sulla superficie, rendono inefficaci gli altri adesivi.

THERMATTACH® T412 è un adesivo acrilico sensibile alla pressione ad elevata forza adesiva, caricato con diboruro di titanio e applicato su uno strato di alluminio espanso. L'unione di questi elementi in aggiunta ad una superficie in rilievo migliora sia la malleabilità dell'adesivo che le sue prestazioni termiche. Il T412 trova il suo impiego ottimale là dove si vuole ottenere la massima dissipazione termica nel fissaggio di dissipatori di piccole o medie dimensioni, sia in alluminio che in rame, su componenti come: chip MOSFET, PLL o BGA.

GOMMINI PROTETTIVI SALVA CORE sono la soluzione ideale per impedire che il core dei processori o dei chipset, sprovvisti di un proprio package protettivo, possano scheggiarsi e rompersi durante il montaggio del dissipatore. Il gommino protettivo è realizzato in modo tale che, una volta sottoposto alla pressione del dissipatore durante il fissaggio sul socket o sulla scheda madre stessa, mantenga quest'ultimo in una posizione perfettamente planare alla superficie del core. Si eviterà, così, il rischio di scaricare il peso sugli spigoli del chip causandone la frattura.